

Intel Xeon Gold 5222 - 3.8 GHz - 4 Kerne - 8 Threads

16.5 MB Cache-Speicher - LGA3647 Socket - OEM

Gruppe	Prozessoren
Hersteller	Intel
Hersteller Art. Nr.	CD8069504193501



Beschreibung

Mit Support für die höchsten Arbeitsspeichergeschwindigkeiten, Speicherkapazität und erweiterte Vier-Sockel-Skalierbarkeit, die Intel Xeon Gold Prozessorreihe liefert deutliche Verbesserung in Sachen Performance, fortschrittliche Zuverlässigkeit und Hardware-verstärkte Speicher. Optimiert für anspruchsvolle Standard-Rechenzentren, Multi-Cloud-Computing und Netzwerk- und Speicher-Workloads. Die Intel Xeon Gold Prozessorreihe bietet verbesserte Performance mit erschwinglicher fortschrittlicher Zuverlässigkeit und Hardware-verstärkter Sicherheit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intel Xeon Gold 5222 / 3.8 GHz Prozessor - OEM
Produkttyp	Prozessor
Prozessortyp	Intel Xeon Gold 5222
Anz. der Kerne	Quad-Core / 8 Threads
Cache-Speicher	16.5 MB
Geeignete Sockel	LGA3647 Socket
Prozessoranz.	1
Taktfrequenz	3.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	3.9 GHz
Herstellungsprozess	14 nm
Funktionen	Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel TSX-NI, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Run Sure Technology, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT)

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Prozessor
	Prozessor

Typ / Formfaktor	Intel Xeon Gold 5222
Anz. der Kerne	Quad-Core
Anz. der Threads	8 Threads
Cache-Speicher	16.5 MB
Cache-Speicher-Details	Smart Cache - 17 MB
Prozessoranz.	1
Taktfrequenz	3.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	3.9 GHz
Geeignete Sockel	LGA3647 Socket
Herstellungsprozess	14 nm
Thermal Design Power (TDP)	105 W
Temperaturspezifikationen	72 °C
PCI Express Revision	3.0
Anz. PCI Express Lanes	48
Architektur-Merkmale	Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel TSX-NI, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Run Sure Technology, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT)
	Verschiedenes
Verpackung	OEM/Tray

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.